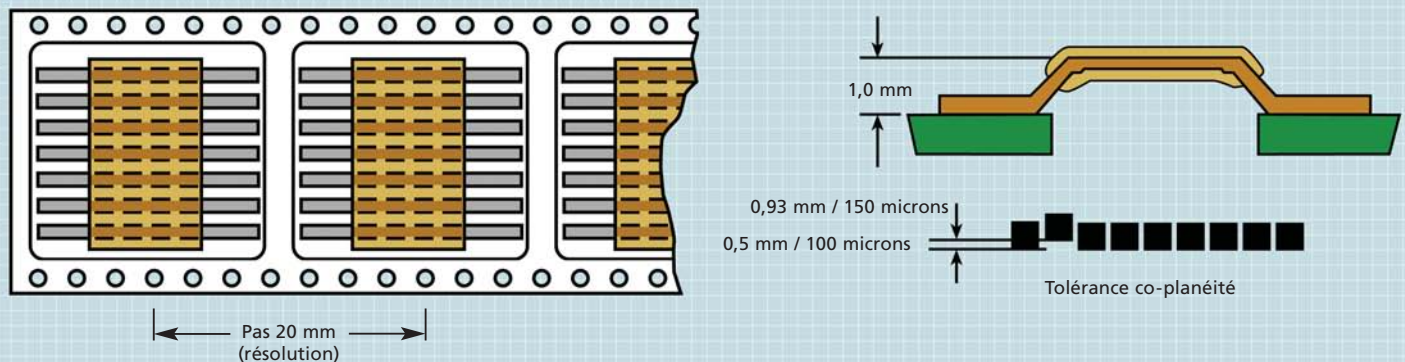


Interconnexions pour montage en surface (SMI)

Pour l'interconnexion entre cartes



Description générale

Les interconnexions pour montage en surface (SMI), développées par Teknoflex, sont les premières au monde à pouvoir être montées automatiquement.

Ces produits sont montés sur une bande de transport enroulée sur une bobine de diamètre standard 13 pouces (330 mm). Chaque bobine contient 1500 circuits comprenant de 4 à 22 conducteurs pour un espacement de 0,93 mm (résolution) ou de 10 à 40 conducteurs pour un espacement 0,50 mm.

Teknoflex a développé de manière intensive cette technologie et a ainsi pu obtenir un niveau de co-planéité permettant de placer avec précision les interconnexions SMI en utilisant toutes les machines standard de placement.

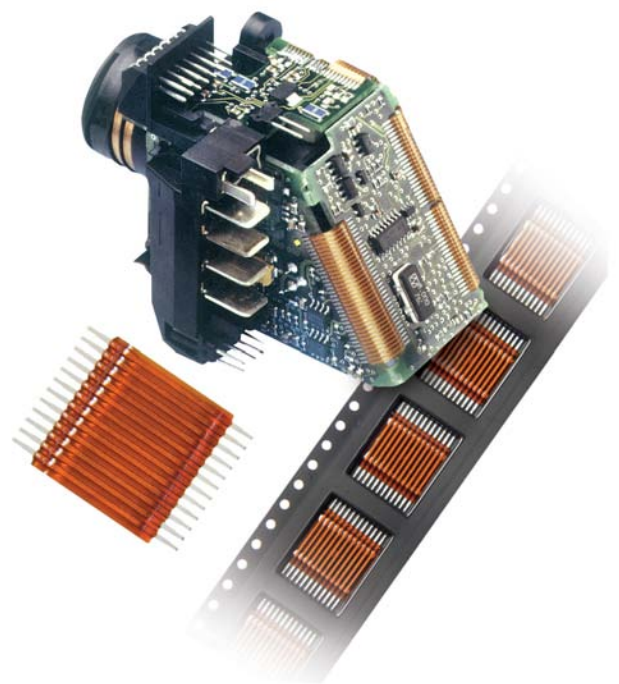
Les interconnexions SMI sont assemblées directement, de la même manière, et pendant le même cycle que tous les autres composants. Les soudures sont réalisées pendant la refusion en utilisant les équipements standard.

C'est un produit peu coûteux idéal pour les connexions de carte à carte. Les structures et les matériaux ont été spécialement sélectionnés pour fournir la solution la plus fiable, la plus économique et la plus efficace.

Applications

La technologie SMI a été utilisée avec succès dans de nombreuses applications, notamment pour l'industrie automobile en grandes séries, la médecine, l'informatique, les alimentations électriques, les capteurs et les équipements optiques.

Contactez notre Service commercial pour plus d'informations.



Interconnexions pour montage en surface (SMI)

Pour l'interconnexion entre cartes

Avantages

- Composant peu coûteux
- Assemblage peu coûteux
- Suppression des connecteurs
- Fourni sous forme de bandes et de bobines (plateau Waffle sur commande spéciale)
- Peuvent être placés automatiquement par machine
- Soudage conventionnel par refusion
- Robuste
- Souple
- Poids léger
- Faible épaisseur
- Permet de passer de fortes intensités de courant
- Excellent pour les applications "montage par cintrage"
- Excellente résistance aux vibrations dans tous les axes

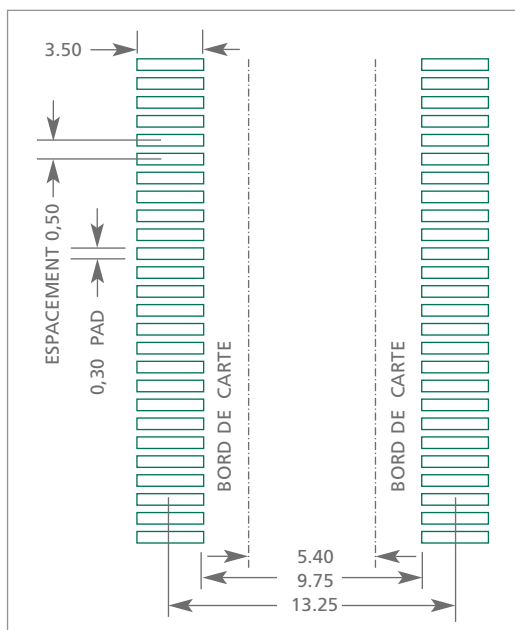
Spécifications

Pas entre les conducteurs Espacement 0,50 mm Espacement 0,93 mm	0,50 mm et 0,93 mm 10 à 40 conducteurs (en standard) 4 à 22 conducteurs (en standard)
Taille standard	Longueur conducteur - 15 mm Largeur - Varie en fonction du nombre des conducteurs Hauteur maximum 1 mm
Epaisseur cuivre (doigt exposé)	250 microns ± 10 %
Epaisseur cuivre (zone souple)	70 microns - 125 microns
Co-planéité des doigts exposés	150 microns (total) espacement 0,93 mm 100 microns (total) espacement 0,50 mm
Epaisseur isolant	25 microns ± 10 %
Matériau isolant	Polyimide (standard)
Gamme de températures	Assemblage 150°C à 250°C typique SMT reflux Fonctionnement -60°C à +125°C cyclique, +105°C en continu
Intensité maximum (par conducteur)	Espacement 0,50 mm 1,0A pour une hausse de température de 10°C par rapport à la température ambiante Espacement 0,93 mm 1,5A pour une hausse de température de 10°C par rapport à la température ambiante
Performance en flexion	Courbure 180° => 100+ cycles rayon de courbure 2 mm
Finition piste	RoHS standard. Autres finitions par exemple étain/plomb disponible sur demande

Conceptions personnalisées disponibles si nécessaire

Détails d'empreinte sur circuit imprimé rigide pour un pas de 0,5 mm

Toutes dimensions en millimètres



CODE DE COMMANDE

SMI - 0.93 - 22 - 11 - KFT(RoHS)

INTERCONNEXION
MONTAGE EN SURFACE

CONFORME ROHS
ETAIN MAT
ÉLECTROLYTIQUE.
AUTRES FINITIONS
SUR DEMANDE

ESPACEMENT REQUIS
(EN MILLIMÈTRES)

LONGUEUR ISOLANT
(EN MILLIMÈTRES)

NOMBRE DES CONDUCTEURS



Teknoflex Limited
Quarry Lane, Chichester,
West Sussex, PO19 8PE
Royaume-Uni

e : sales@teknoflex.com
t : +44 (0)12 4383 2800
f : +44 (0)12 4383 2832
w : www.teknoflex.com

Vos idées de la conception jusqu'à leur réalisation

Teknoflex™ est une marque déposée. Le texte et les images de cette brochure sont protégés par un droit de reproduction (copyright) et ne doivent pas être reproduits sans l'autorisation préalable de Teknoflex.